

EV Group Expands Collaboration with ITRI on Heterogeneous Integration Process Development – August 30, 2022

オーストリア ザンクト・フローリアン, 2022年8月31日 /PRNewswire-AsiaNet/ -- MEMS、ナノテクノロジーデバイス、半導体製造向けウェーハ接合およびリソグラフィ装置のリーディングサプライヤーであるEV Group（以下、EVG）は本日、工業技術研究院（ITRI）との協力関係を強化したことを発表しました。ITRIは台湾・新竹に拠点を置く世界有数の応用技術研究機関の1つであり、高度な異種材料統合プロセスの開発に取り組んでいます。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/1888386/EV_Group_Building.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/1888387/EV_Group_Tool.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1278751/EV_Group_Logo.jpg

ITRIは、台湾の産業技術省（DoIT）と経済部（MOEA）の支援を受けて、パッケージ設計、テスト、検証、そしてパイロット生産を網羅する完全なエコシステムを構築するための異種材料統合チップレットシステムパッケージアライアンス（Hi-CHIP）を設立しました。これにより、サプライチェーンの現地化とビジネスチャンスの拡大を目指します。Hi-CHIP アライアンスのメンバーとしてEVGは、EVGのLITHOSCALE(R)マスクレス露光リソグラフィシステム、EVG(R)850DB自動剥離装置、そしてGEMINI(R)FBハイブリッド接合装置など、複数台のEVG最先端ウェーハ接合装置およびリソグラフィ装置を提供しました。ITRIの最先端施設にこれらの量産向けプラットフォームを設置することにより、EVGとITRIの共通の顧客が、新しい異種材料統合プロセスの開発を加速させ、研究開発から顧客の生産工場へのスムーズな移行を可能にします。

<https://news.infoseek.co.jp/article/kyodopr202208315738/>